

HOME PATENTWEB TRADEMARKWEB WHAT'S NEW PRODUCTS & SERVICES ABOUT MICROPATENT



MicroPatent's Patent Index Database: Record 1 of 1 [Individual Record of JP2002167575A]

[Order This Patent](#)

[Family Member\(s\)](#)

JP2002167575A  20020631 FullText

Title: (ENG) POLISHING COMPOSITION AND POLISHING METHOD FOR POLISHING MEMORY HARD DISK USING THE SAME

Abstract: (ENG)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polishing composition improved in dripping at an edge face compared with conventional polishing compositions in polishing a substrate used for a memory hard disk, and to provide a polishing method.

SOLUTION: The polishing composition comprises ingredients: (a) water, (b) at least one compound selected from the group consisting of polyoxyethylene polyoxypropylene alkyl ethers and polyoxyethylene polyoxypropylene block copolymers, (c) at least one compound selected from the group consisting of nitric acid, nitrous acid, sulfuric acid, hydrochloric acid, molybdic acid, sulfamic acid, glycine, glyceric acid, mandelic acid, malonic acid, ascorbic acid, glutamic acid, glyoxylic acid, malic acid, glycolic acid, lactic acid, gluconic acid, succinic acid, tartaric acid, maleic acid and citric acid, and salts thereof, and (d) at least one polishing material selected from the group consisting of aluminum oxide, silicone oxide, cerium oxide, zirconium oxide, titanium oxide, silicon nitride and silicon carbide. The polishing method of a memory hard disk using the same is also provided.

Application Number: JP 2000362739 A

Application (Filing) Date: 20001129

Priority Data: JP 2000362739 20001129 A ;

Inventor(s): SUGIYAMA HIROYASU ; ISHIBASHI TOMOAKI ; TAKAHASHI TOSHIYUKI

Assignee/Applicant/Grantee: FUJIMI INC

Last Modification Date: 20051121

Original IPC (1-7): C09K00314; B24B03700; C09K01304; C09K01306; G11B00584

ECLA (European Class): C09G00102; C09K00314D2; G11B00584B

Patents Citing This One (1):

→ US6902591B2 20050607 KAO CORP JP  
Polishing composition



Copyright © 2002, MicroPatent, LLC. The contents of this page are the property of MicroPatent LLC including without limitation all text, html, asp, javascript and xml. All rights herein are reserved to the owner and this page cannot be reproduced without the express permission of the owner.

(39) 日本国特許庁 (JP)

(2) 公開特許公報 (A)

(1) 特許出願公開番号

特開2002-167575

(P2002-167575A)

(3) 公開日 平成14年6月11日 (2002.6.11)

(51) Int.Cl.  
C09K 3/14  
B24B 37/00  
C09K 13/04

識別記号  
550  
B24B 37/00  
C09K 13/04

102

F I  
C09K 3/14  
B24B 37/00  
C09K 13/04

550D 2C058  
550Z SD112  
H

102

審査請求 未請求 請求項の数 6 O.L. (全 10 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-362739(P2000-362739)

(71) 出願人 000236702

株式会社フジミインコーポレーテッド  
愛知県西春日井郡西枇杷島町地錆2丁目1  
番地の1

(22) 出願日 平成12年11月29日 (2000.11.29)

(72) 発明者 杉山 博保

愛知県西春日井郡西枇杷島町地錆2丁目1  
番地の1 株式会社フジミインコーポレー  
テッド内

(74) 代理人 100061273

弁理士 佐々木 宗治 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 研磨用組成物、およびそれを用いてメモリーハードディスクを研磨する研磨方法

(57) 【要約】

磨方法。

【課題】 メモリーハードディスクに使用されるサブストレートの研磨において、従来の研磨用組成物に比べ、輪廻ダレを改善することができる研磨用組成物、および研磨方法を提供する。

【解決手段】 (a) 水、(b) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンプロックコポリマーからなる群から選択される少なくとも1種類の化合物、(c) 硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルフィアミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リノロ酸、ダリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにそれらの塩からなる群から選択される少なくとも1種類の化合物、および(d) 酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種類の研磨材の各成分を含んでなる研磨用組成物、およびそれを用いたメモリーハードディスクの研

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の(a)～(d)の各成分を含むことを特徴とする、メモリーハードディスクの研磨用組成物。

(a) 水、(b) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーからなる群から選択される少なくとも1種の化合物、(c) 硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにそれらの塩からなる群から選択される少なくとも1種の化合物。および(d) 酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、塗化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材。

【請求項2】 前記(c)の塩が、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(II)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1に記載の研磨用組成物。

【請求項3】 前記(c)の塩が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1に記載の研磨用組成物。

【請求項4】 下記の(a)～(d)の各成分を含む研磨用組成物を用いてメモリーハードディスクを研磨する研磨方法。

(a) 水、(b) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーから選択される少なくとも1種類の化合物群から選択される少なくとも1種類の化合物、(c) 硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにそれらの塩からなる群から選択される少なくとも1種の化合物、および(d) 酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、塗化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材。

【請求項5】 前記(c)の塩が、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(II)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項4に記載のメモリーハードディスクを研磨する研磨方法。

【請求項6】 前記(c)の塩が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項4に記載のメモリーハードディスクを研磨する研磨方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、メモリーハードディスク、すなわちコンピューターなどに用いられる記憶装置に使用される磁気ディスク用基盤の製造において、その表面の研磨に好適な研磨用組成物およびそれを使用する研磨方法に関するものである。

【0002】 さらに詳しくは、本発明は、Nイードディスク、Nイードディスク、アルミニウムディスク、ガラスディスク、ポロンカーバイドディスク、およびカーボンディスク等に代表されるメモリーハードディスクに使用されるディスク基盤（以下、サブストレートといいう）の研磨における、好適な研磨用組成物およびそれを使用した研磨方法に関するものであり、従来の研磨用組成物で研磨されたサブストレートに比べて、その外周部（以下、「エッジ部」という）の端面ダレを悪化させることなく研磨でき、より高密度かつ高記憶密度の磁気ディスク装置を製造することを可能とするものである。

## 【0003】

【従来の技術】 コンピューターなどの記憶媒体のひとつである磁気ディスク装置に使用されるメモリーハードディスクは、年々小型化、高容量化、低価格化の一途をたどっている。現在、最も広く普及しているサブストレートのひとつに、ブランク材に無電解Nイードメッキを被膜したものがある。ブランク材とは、サブストレートの基材であるアルミニウムおよびその他の基材を、平行度や平坦度を持たせる目的でダイヤカーンによる加工、SPC研磨材を用いて作られたPVA砥石を用いたウップ加工、およびその他の方法により整形したものである。しかし、前記の各種整形方法では比較的大きなうわりは完全には除去できない。そして、このブランク材に被膜される無電解Nイードメッキも前記のうねりに沿って成

磨されるためには、サブストレートにも前記のうねりが残ってしまうことがある。このサブストレートのうねりを除去し、表面を平滑化する目的で研磨が行われている。

【0004】メモリーハードディスクの高容量化とともに、記憶密度は年々数%の割合で向上している。従って、記憶される一定量の情報が占めるメモリーハードディスク上のスペースは、ますます狭くなり、記憶に必要な磁力は弱くなっている。このために、最近の磁気ディスク装置では、磁気ヘッドとメモリーハードディスクの隙間であるヘッド浮上高を小さくする必要に迫られている。

【0005】また、情報の読み書きを行う磁気ヘッドがメモリーハードディスクへの吸着や、サブストレート表面への研磨による、メモリーハードディスクの回転方向とは異なる一定方向に筋目がつくことにより、メモリーハードディスク上の磁界が不均一になることを防止する目的で、研磨後のサブストレートに同心円状の筋目をつける、いわゆるテクスチャー加工が行われることがある。

【0006】最近では、ヘッド浮上高をさらに低くする目的で、サブストレート上に施す筋目をより薄くしたライトテクスチャー加工が行われたり、さらにはテクスチャー加工を行わずに筋目をつけないノンテクスチャーのサブストレートも用いられたりするようになっている。このように、磁気ヘッドの低浮上化をサポートする技術も開発され、ヘッドの低浮上化がますます進んできている。そのため、そのヘッド浮上高は0.02μm以下にまで及んでいる。

【0007】磁気ヘッドは、非常に高速で回転しているメモリーハードディスクの表面の形状に沿って浮上しているが、メモリーハードディスク表面に数μm程度のピットが存在した場合、情報が完全に書き込まれず、いわゆる「ピット落ち」と呼ばれる情報の欠落や情報の読み取り不良が発生し、エラー発生の原因となることがある。

【0008】なお、ここでいう「ピット」とは、サブストレートにもともと存在するへこみや、研磨によりサブストレート表面に発生した凹みのことであり、また微細なピットとは、そのうち直徑が概ね0.1μm未満の凹みのことである。

【0009】従って、磁性媒体を形成させる前工程、すなわち、研磨加工工程においてサブストレート表面の粗さを小さくすることが極めて重要であると同時に、微小突起やピット、およびその他の表面欠陥を効果的にかつ効率で除去する必要がある。

【0010】前記目的のために、従来は、酸化アルミニウムまたはその他の各種研磨材、水、および各種の研磨促進剤を含む研磨用組成物を用いて研磨されていた。例えば、特開昭61-278587号公報および特開昭63-25187号公報には、水と水酸化アルミニウム

に、研磨促進剤として硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、または硫酸ニッケルなどを添加し、混合してスライドとしたメモリーハードディスクの研磨用組成物が開示されている。

【0011】また、特開平2-84485号公報には、水とアルミナ研磨材微粉に、研磨促進剤としてグルコン酸または乳酸と、表面改質剤としてコロイダルアルミニウムとからなる酸性のアルミニウム磁気ディスクの研磨用組成物が、特開平7-133477には、アルミナ研磨材、コロイダルアルミニウム、及び硫酸アルカリ塩を含む水系研磨用組成物が、また特開平9-31643りでは、水、タルミナおよび研磨促進剤を含んでなる組成物であって、該研磨促進剤がショウ酸アルミニウムからなることを特徴とする磁気ディスク基板研磨用組成物が開示されている。

【0012】しかしながら、前述した従来の研磨用組成物を用いてサブストレートを研磨した場合、研磨中にサブストレートのエッジ部が平面よりも顯著に加工されてしまい、サブストレートの外周部における端面ダレが生じてしまうという問題があった。エッジ部に面ダレが生じたサブストレートでは、そのエッジ部におけるデータの記憶が不可能となり、そのためデータの記憶領域が少なくなってしまうという問題を生じた。

【0013】従って、高容量かつ高記憶密度の磁気ディスク装置を製造する場合においては、エッジ部における端面ダレが重要な問題となり、この端面ダレを少なくすることにより、エッジ部も効率的に利用して記憶面積をより広くし、記憶容量を増加させることが求められている。

【0014】端面ダレを生じさせる原因としては、研磨時の加工条件と並んで研磨組成物による影響が大きいということがわかっている。よって研磨中ににおいてエッジ部の端面ダレを悪化させることなく、高容量かつ高記憶密度の磁気ディスク装置を得ることが可能な研磨用組成物が望まれてきた。

【0015】なお、端面ダレを評価する場合、端面ダレの生じたエッジ部の形状、及び深さ（ダレ幅）を求めるため、基本的には2つの測定値が使用される。即ち、後述するRo11-01fとRo11b-01fであり、この2つの測定値によって評価されることが多い。しかしながら、この評価しようとする項目は同じであるが、実質的に形状の測定方法及び測定位臯に基づく測定値における許容限界としての基準値については、使用する測定装置の特性の違いもあり、一般的には定義されておらず、この基準値についてでは、各製造者の判断に任せられていることが多いまちまちである。

【0016】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の問題点を解決するためのものであり、メモリーハードディスクを使用されるサブストレートの研磨において、従来の

研磨用組成物に比べて顕著ダメージを悪化させることができず、高密度かつ高記憶密度の磁気ディスク装置を得ることが可能な研磨用組成物およびそれによる研磨方法を提供することを目的とするものである。

## 【0017】

【課題を解決するための手段】前記の課題を本発明は、以下により解決する。即ち、(a)水、(b)ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシブロピレンコポリマーから選択される少なくとも1種類の化合物群から選択される少なくとも1種類の化合物、(c)硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにそれらの塩からなる群から選択される少なくとも1種類の化合物、および

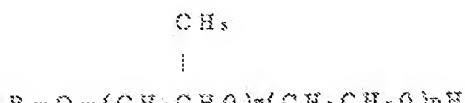
(d)酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、塩化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材の各成分を含む研磨用組成物を用いた研磨方法により課題を解決する。

【0018】また、前記(c)の塩が、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(III)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする研磨用組成物により解決するものである。

【0019】また、前記(c)の塩が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする研磨用組成物により解決する。

【0020】更に、本発明は、(a)水、(b)ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシブロピレンコポリマー

ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンアルキルエーテル



【0024】但し、式中Rはアルキル基を示し、mはブロピレングリコールの付加モル数、nはエチレングリコ

ーから選択される少なくとも1種類の化合物群から選択される少なくとも1種類の化合物、(c)硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにそれらの塩からなる群から選択される少なくとも1種の化合物、および

(d)酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、塩化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材の各成分を含む研磨用組成物を用いた研磨方法により課題を解決する。

【0021】更にまた、前記(c)の塩が、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(III)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする研磨用組成物を用いた研磨方法により、また、前記(c)の塩が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする研磨用組成物を用いた研磨方法により、課題を解決する。

## 【0022】

【発明の実施の形態】発明の研磨用組成物は、化合物(b)として、ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシブロピレンコポリマーから選択される少なくとも1種類の化合物を含むことを特徴としている。ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンアルキルエーテルは、下記式に示される構造式をもち、直鎖あるいは側鎖の高級アルコールに酸化ブロピレン及び酸化エチレンを付加重合させたものである。

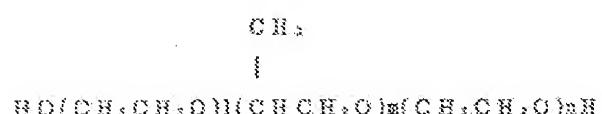
## 【0023】

## 【化1】

ールの付加モル数を表す整数が入る。

【0025】ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーは、以下のプロックタイプとランダムタイプに分類される。ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロッタコポリマーは、下記構造式に示すような構造を持ち、酸化プロピレンを重合させたポリプロピレングリコールを親水基として、その両端に酸化エチレンを親水基として付加重合させたタイプ、または酸化エチレンを重合させたポリエチレングリコールの両端にポリプロピレングリコールを付加重合させたタイプである。<sup>\*</sup>10 【化2】

ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロッタコポリマー



又は



【0027】但し、式中1, m, n, はそれぞれ任意の整数である。

【0028】本発明におけるポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーの分子量は、特に限定されないが、平均分子量で1,500～100,000の化合物であることが好ましく、さらに1,500～20,000であることより好ましい。また、分子内に親水基のみ又は疎水基のみでは効果は発現しないことからも、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーの親水基（エチレンオキサイド）あるいは疎水基の付加モル数のバランスが重要であり。分子内における親水基の付加量%が10%～80%であることが好ましい。ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルには、本発明の効果を損なわない範囲で任意のアルキル基を持つことができる。

【0029】本発明に於いてポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーの含有量は、研磨用組成物の全重量を基準として、好ましくは0.001～2重量%，より好ましくは0.005～1重量%の割合で含有されるのがよい。これらの添加によりR.O.I.～O.I.，及びD.u.b.～O.I.性能が改善される傾向があるが、添加量が過少であれば十分な効果が期待できず、逆に過度に増加すると研磨速度や加工能力の低下が起こってしまうことが懸念される。

【0030】また、前記したポリオキシエチレンポリオ

キシプロピレンアルキルエーテル及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーは、組成物中に含まれている必要がある。また、本発明の効果を損なわない範囲で、複数の種類のポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーを併用することや、両者を任意の割合で併用することも可能である。

【0026】

【化2】

ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロッタコポリマー

キシプロピレンアルキルエーテル及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーは、組成物中に含まれている必要がある。また、本発明の効果を損なわない範囲で、複数の種類のポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーを併用することや、両者を任意の割合で併用することもできる。

【0031】本発明の研磨用組成物は、化合物(c)として、硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイイン酸、およびクエン酸、ならびにそれらの塩または誘導体からなる群から選択される、少なくとも1種類の化合物（以下、「酸化合物」という）を含んでなる。

【0032】具体的に酸化合物の塩としては、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(II)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケル、およびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される。

【0033】また、本発明において、好ましい酸化合物は有機酸であり、具体的にはグリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン

酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸、およびケン酸が挙げられる。酸化合物として、有機酸が好まれる理由としては、今回の発明とは直接関係がないが、一般的に無機酸と比較すると研磨時に於けるバッドの目詰まりが少なく、酸化合物として好適に使用されているという傾向に基づくものである。

【0034】これらの酸化合物は、組成物中に浴存しているべきである。また、これらの酸化合物は、本発明の効果を損なわない範囲で、任意の割合で併用することができる。

【0035】本発明の研磨用組成物中における酸化合物の好適な添加量は、用いる酸化合物の種類により異なるが、研磨用組成物の全重量に対して、好ましくはり、0.1～2.5重量%、より好ましくはり、1～2.0重量%、更に好ましくはり、2～1.0重量%である。酸化合物の添加量を増加することで、研磨速度が大きくなる傾向があるが、過度に多く添加すると研磨用組成物のケミカルな作用が強くなり、微小突起、微細なピット、およびその他の表面欠陥が発生することがある。逆に過度に少ないとき、研磨速度が小さくなり、微細なピット、微小突起、およびその他の表面欠陥を抑制する効果が十分に発現しないことがある。また、過度に多く添加した場合、輪番ダレを悪化させるような傾向については特に見られていない。

【0036】本発明の研磨用組成物において適当な研磨材は、酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、窒化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種類である。

【0037】酸化アルミニウムには、 $\alpha$ -アルミナ、 $\gamma$ -アルミナ、 $\delta$ -アルミナ、 $\epsilon$ -アルミナ、およびその他の形態的に異なるものがある。また製造法からフュームドアルミナと呼ばれるものもある。また、二酸化ケイ素には、コロイダルシリカ、フュームドシリカおよびその他の製造法や性状の異なるものが多種存在する。

【0038】酸化セリウムには、膨化球から3種のものと4種のもの、また結晶系から見て、六方晶系、等軸晶系、および面心立方晶系のものがある。また、酸化ジルコニウムは、結晶系から見て、单斜晶系、正方晶系、および非晶質のものがある。また、製造法からフュームドジルコニアと呼ばれるものもある。

【0039】酸化チタンには、結晶系から見て、一酸化チタン、三酸化二チタン、二酸化チタンおよびその他のものがある。また製造法からフュームドチタニアと呼ばれるものもある。また、窒化ケイ素は、 $\alpha$ -窒化ケイ素、 $\beta$ -窒化ケイ素、アモルファス窒化ケイ素、およびその他の形態的に異なるものがある。

【0040】炭化ケイ素には、 $\alpha$ -炭化ケイ素、 $\beta$ -炭化ケイ素、アモルファス炭化ケイ素、およびその他の形

態的に入るものがある。

【0041】なお、本発明の研磨組成物には、これらのものを任意に、必要に応じて組み合わせて使用することができる。組み合わせる場合には、その組み合わせ方法や使用する成分割合は特に限定されない。

【0042】上記の研磨材は、研粒としてメカニカルな作用により被研磨面を研磨するものである。研粒の大きさとしては、研粒の種類によって、また被加工品の種類や加工条件、さらにサブストレートに要求されるスペックにより異なり。特に制限されるものではないが、二酸化ケイ素の粒径は、SEM法により測定した表面積から求められる平均粒子径で好ましくは、0.005～0.5  $\mu\text{m}$ 、特に好ましくはり、0.1～0.3  $\mu\text{m}$ 、である。

【0043】また、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、窒化ケイ素、および炭化ケイ素の粒径は、レーザー回折式粒度測定器LS-230(Coors Inc.社(米国)製)で測定した平均粒子径で、好ましくはり、0.1～2  $\mu\text{m}$ 、特に好ましくは0.05～1.5  $\mu\text{m}$ 、である。さらに、酸化セリウムの粒径は、走査型電子顕微鏡により観察される平均粒子径で、好ましくは0.01～0.5  $\mu\text{m}$ 、特に好ましくは0.05～0.45  $\mu\text{m}$ 、である。

【0044】これらの研磨材の平均粒子径が、ここに示した範囲を超えて大きいと、研磨された表面の表面粗さが大きかったり、スクランチが発生したりするなどの問題が生ずるおそれがあり、加工時には注意が必要である。逆に、ここに示した範囲よりも小さいと、研磨速度が極端に小さくなってしまい研磨用組成物としては実用的でない。

【0045】研磨用組成物中の研磨材の含有量は、組成物全量に対して一般に0.1～5.0重量%、鮮ましくは1～2.5重量%，である。研磨材の含有量が余りに少ないと、微小突起や微細なピット、およびその他の表面欠陥が発生し易く、研磨速度も小さくなることがあり、逆に余りに多いと均一分散性が保てなくなり、かつ組成物粘度が過大となって、取り扱いが困難となることがある。

【0046】本発明の研磨用組成物に使用する水については、特に制限はないが、上記の各成分が正確にその役割を果たせるよう、不純物の少ないものであることが好ましい。すなわち、イオン交換樹脂にて不純物イオンを除去し、フィルターを通して懸濁物を除去したもの、または、蒸留水であることが好ましい。

【0047】<研磨用組成物>本発明の研磨用組成物は、一般に上記の各成分、すなわち酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、窒化ケイ素、および二酸化マンガンからなる群より選ばれる少なくとも1種類の研磨材(成分(d))を所望の含有率で水(成分(a))に混合し、分散さ

11

せ、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマー（成分（b））、および酸化合物（成分（c））をさらに溶解させることにより調製する。

【0048】また、これらの成分を水中に分散または溶解させる方法は任意であり、例えば、翼式攪拌機で攪拌したり、超音波分散により分散させる。また、これらの混合順序は任意であり、研磨材の分散とポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、または酸化合物の溶解のいずれを先に行ってもよく、また同時に行ってもよい。

【0049】更に、上記の研磨用組成物の調製に際しては、製品の品質保持や安定化を図る目的や、被加工物の種類、加工条件およびその他の研磨加工上の必要に応じて、各種の公知の添加剤を更に加えててもよい。

【0050】すなわち、更なる添付剤の好適な例としては、下記のものが挙げられる。

(イ) 水溶性アルミナゾル、(ロ) 有機ポリアニオン系物質、例えば、リグエンスルホン酸塩、ポリアクリル酸塩など、(ハ) 水溶性高分子（乳化剤）類、例えば、ポリビニルアルコールなど、(ニ) キレート剤、例えば、ジメチルグリオキシム、ジチゾン、オキシン、アセチルアセトン、エリTA、NTAなど、(ホ) 過酸化水素、ならびに(ヘ) 練剤、例えば、炭酸水素カリウムなど。ただし、添加量および組み合わせによっては端面ダレを悪化させてしまうこともあるために注意が必要である。

【0051】本発明の研磨用組成物は、比較的高濃度の原液として調製して、貯蔵または輸送などをし、実際の研磨加工時に希釈して使用することもできる。前述の好

12

ましい濃度範囲は、実際の研磨加工時のものとして記載したものであり、使用時に希釈して使用する方法をとる場合、貯蔵または輸送などをされる状態においては、より高濃度の溶液となることは言うまでもない。また、取り扱いの観点から、そのような濃縮された形態で製造されることが好ましい。

【0052】本発明の研磨用組成物が、端面ダレを悪化させることのない理由についての詳細なメカニズムは不明である。しかし、このエッジ部の端面ダレを悪化させない理由は、研磨時における摩擦が低減することによるものと推測される。これらのものを添加することにより、加工性能にも改善効果が見られることがわかっている。

【0053】以下は、本発明の研磨用組成物の例を用いて具体的に説明するものである。なお、本発明は、その要旨を超えない限り、以下に説明する諸例の構成を限定されるものではない。

【0054】

【実施例】<研磨用組成物の調製>まず、研磨材として、平均粒子径が0.8μmである微粒化アルミニウムを攪拌機を用いてそれぞれ水に分散させて、研磨材濃度が研磨用組成物全量の重量に対して20重量%になるよう調製した。一方、有機酸または無機酸水溶液にポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーを添加して、実施例1～20を、また、無添加品及び各種のグリコール類を添加した比較例1～7の試料を調製した。

【0055】

【表1】

試験番号	被検査物 (商品名)	溶剤	溶剤量	表面粗さ		
				平均値	標準偏差	規格値(ISO13618:1993)
実験例 1	リング波	1.0	P E P P	2.200	1.5	0.85
実験例 2	リング波	1.0	P E P P	2.200	1.6	0.85
実験例 3	グリコール波	2.0	P E P P	2.200	1.8	0.85
実験例 4	マレイン波	1.0	P E P P	2.200	1.6	0.85
実験例 5	コハク波	1.0	P E P P	2.200	1.9	0.85
実験例 6	硫酸アルミニウム	4.0	P E P P	2.200	1.9	0.85
実験例 7	リング波	1.0	P E P P	2.200	6.2	0.85
実験例 8	硫酸アルミニウム	4.0	P E P P	2.200	4.9	0.85
実験例 9	リング波	1.0	P E P P	2.200	8.5	0.85
実験例 10	硫酸アルミニウム	4.0	P E P P	2.200	8.6	0.85
実験例 11	リング波	1.0	P E P P	2.200	8.6	0.85
実験例 12	硫酸アルミニウム	4.0	P E P P	2.200	8.5	0.85
実験例 13	リング波	3.0	P E P A	1.000	3.0	0.85
実験例 14	リング波	3.0	P E P A	1.000	2.5	0.85
実験例 15	グリコール波	2.0	P E P A	1.000	3.5	0.85
実験例 16	マレイン波	1.0	P E P A	1.000	3.0	0.85
実験例 17	コハク波	1.0	P E P A	1.000	3.6	0.85
実験例 18	硫酸アルミニウム	4.0	P E P A	1.000	3.6	0.85
実験例 19	リング波	1.0	P E P A	2.500	8.6	0.85
実験例 20	硫酸アルミニウム	4.0	P E P A	2.500	8.6	0.85
比較例 1	リング波	1.0	無効化	—	—	—
比較例 2	グリコール波	2.0	無効化	—	—	—
比較例 3	マレイン波	1.0	無効化	—	—	—
比較例 4	コハク波	1.0	無効化	—	—	—
比較例 5	硫酸アルミニウム	4.0	無効化	—	—	—
比較例 6	リング波	1.0	P C	—	—	0.85
比較例 7	リング波	1.0	P C	—	—	0.85

P E P P : ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロッカボリマー

P E P A : ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンランダムコポリマー

P E P M : ポリオキシエチレンポリオキシブレニカルキルエーテル

P C : シアボビレンジグリコール

D P G : シアボビレンジグリコール

〔0056〕&lt;研磨試験&gt;次に、上記の研磨用組成物で \* の通りである。

サブストレートを用いて研磨試験を行った。条件は下記\*

## 研磨条件:

被加工物 3.5インチ無縫鋼N1-Pメッキサブストレート  
 加工枚数 15枚  
 研磨機 両面研磨機(底盤径700mm)  
 研磨パッド Kaneko 0048(綿紡製)  
 加工圧力 100g/cm<sup>2</sup>  
 上走盤回転数 24 rpm  
 下走盤回転数 16 rpm  
 組成物希釈率 1:3純水  
 研磨用組成物供給量 1.50cc/min  
 加工量 取り代にして3μm(両面)

(予備テストを行い、取代が一定となるよう各々の研磨時間を見定した)

〔0057〕<端面ダレ評価方法>MicroXAM (PhaseShift社製)を用いて、サブストレートエッジ部の端面ダレの形状を図1の位相で測定し評価した。尚、図はサブストレートの端部断面を示し、水平方向(×軸)がサブストレート表面直徑輪を、垂直方向がサブストレート厚み方向を示している。このR o 1-O f f, D u b -O f fに關する測定方法については、測定位置及び測定方法の一概的な定義ではなく、各製造者の任意の規定によるものであるが、今回、発明者は図1のような測定ポイントを評価することで端面ダレを評価した。なお、本方法は、サブストレートエッジ部の端面ダレを評価するに際し、適切であり、かつ通常用いられる方法である。

〔0058〕研磨後、サブストレートを洗浄後、乾燥し

た後、研磨によるサブストレートの端面減を測定し、あらかじめ設定されたそれぞれの研磨時間で除することにより研磨速度を求めた。

〔0059〕研磨用組成物についての端面ダレ(R o 1-O f f, D u b -O f f)評価基準については下記の通りである。すなわち、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンゴリマーを含まない組成(比較例1)を基準値。とし、R o 1-O f f, D u b -O f fの各測定値H<sub>o</sub>, H<sub>d</sub>を、基準値H<sub>o</sub>と比較した次式により改善効果A(%)を求めた。

〔0060〕

$$A(\%) = (1 - (H_o, H_d) / H_o) \times 100$$

A: 改善効果(%)

H<sub>o</sub>, H<sub>d</sub>: 測定値

H<sub>o</sub>: 基準値(比較例1における測定値)

[0061] 改善効果Aは、下記により評価し、評価結果を表2に示す。

○：改善効果が20%以上

△：改善効果が10%以上～20%未満

×：改善効果が10%未満

[0062]

(表2)

	研磨速度 μm/分	端面	
		Ru0-0f	Du0-0f
実施例1	0.57	◎	◎
実施例2	0.59	◎	◎
実施例3	0.54	◎	◎
実施例4	0.55	◎	◎
実施例5	0.55	◎	◎
実施例6	0.55	◎	◎
実施例7	0.54	◎	◎
実施例8	0.64	◎	◎
実施例9	0.56	◎	◎
実施例10	0.51	◎	◎
実施例11	0.53	◎	◎
実施例12	0.62	◎	◎
実施例13	0.58	◎	◎
実施例14	0.60	◎	◎
実施例15	0.59	◎	◎
実施例16	0.55	◎	◎
実施例17	0.58	◎	◎
実施例18	0.63	◎	◎
実施例19	0.55	◎	◎
実施例20	0.64	◎	◎
比較例1	0.63	×	×
比較例2	0.60	×	×
比較例3	0.63	×	×
比較例4	0.64	×	×
比較例5	0.59	×	×
比較例6	0.50	×	×
比較例7	0.51	×	×

[0063] 表2に示した結果より、実施例1～20であらわされた本発明の研磨用組成物は、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーを含まない組成である従来の研磨用組成物(比較例1～5)や、他のグリコール類(比較例6～7)を添加したものに比べて、Ru0-0f-Du0-0fの改善効果が大きく、サブストレートの端面ダレを効果的に防止していることがわかる。

[0064]

[発明の効果] 本発明の研磨用組成物は、メモリーハードディスクに使用されるサブストレートの研磨において、

従来の研磨用組成物に比べて端面ダレを悪化させることがないこと、また、本発明によるメモリーハードディスクの研磨方法によれば、従来の研磨用組成物を用いた場合に比べて端面ダレを悪化させることなく、より高密度かつ高記憶密度であるメモリーハードディスクを製造することができる。

[0065] 即ち、1) (a) 水、(b) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーからなる群から選択される少なくとも1種の化合物、(c) 硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにこれらの塩からなる群から選択される少なくとも1種の化合物、および(d) 酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、二氧化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材の各成分を含んでなる研磨用組成物により、従来に比べて端面ダレが少ないサブストレートの研磨が可能となつた。

[0066] 2) 前記(c)の塩を、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(II)、無硝酸ナトリウム、無硝酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(II)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(II)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種とすることにより、端面ダレが極めて少ないサブストレートの研磨が可能となつた。

[0067] 3) 前記(e)の塩を、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種とすることにより、取り扱いがより容易で、かつ端面ダレが極めて少ないサブストレートの研磨が可能となつた。

[0068] 4) (a) 水、(b) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーから選択される少なくとも1種類の化合物群から選択される少なくとも1種類の化合物、(c) 硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにこれらの塩からなる群から選択さ

れる少なくとも1種の化合物、および(d)酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、二氧化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材、の各成分を含む研磨用組成物を用いた研磨方法により、メモリーハードディスクのR.O.I.-O.I.f.、Dub-O.I.f.性能を改善することができる。

【0069】(5)前記(c)の塩を、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硫酸鉄(III)、亜硝酸ナトリウム、無硝酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(III)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種とし本

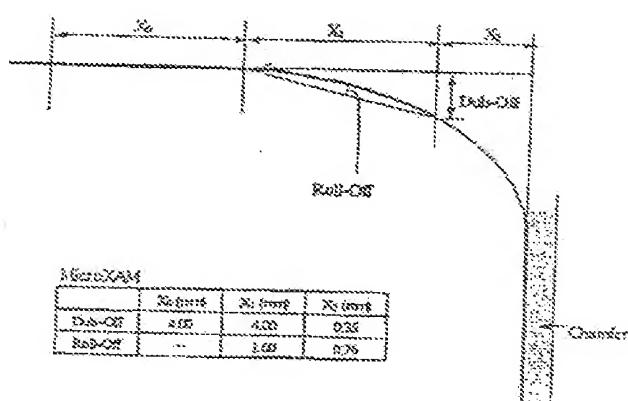
\*た研磨方法により、メモリーハードディスクのR.O.I.-O.I.f.、Dub-O.I.f.性能を極めて改善することができる。

【0070】(6)前記(c)の塩を、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびシエン酸からなる群から選択される少なくとも1種とした研磨方法により、サブストレートの研磨時におけるバッドの閉結まりを防止し、取り扱いを容易とし、メモリーハードディスクのR.O.I.-O.I.f.、Dub-O.I.f.性能を極めて改善することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】サブストレートエッジ部の端面ダレの評価のための測定位置を示す図である。

【図1】



フロントページの続き

(63)Int.Cl.  
C09K 13/06  
G 11 B 5/34

識別記号  
I O I

F 1  
C09K 13/06  
G 11 B 5/34

マーク(F(参考))

I O I  
A

(72)発明者 石橋 勉  
愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1 株式会社フジミインコーポレーション内

(72)発明者 斎橋 幸幸  
愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1 株式会社フジミインコーポレーション内  
マーク(参考) :SC058 AA07 AC04 DA02 DA17  
SE012 AA02 AA24 GA14

【公報種別】特許第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成15年2月13日(2003.2.13)

【公開番号】特開2002-167575 (P2002-167575A)

【公開日】平成14年6月11日(2002.6.11)

【平成号数】公開特許公報14-1676

【出願番号】特願2000-362739 (P2000-362739)

【国際特許分類第7版】

C09K 3/14 S50

B24B 37/00

C09K 13/04

102

13/06

101

C11B 5/84

【EFT】

C09K 3/14 S50 D

S50 Z

B24B 37/00 R

C09K 13/04

102

13/06

101

C11B 5/84 A

【手続補正書】

【提出日】平成14年11月1日(2002.11.1)

【手続補正】

【補正対象審査名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の(a)～(d)の各成分を含んでなることを特徴とする、メモリーハードディスクの研磨用組成物。

(a) 水、

(b) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーからなる群から選択される少なくとも1種の化合物、

(c) 硝酸、亜硝酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リノール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1に記載の研磨用組成物、

合物、および

(d) 酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、塗化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材。

【請求項2】 前記(c)の塩が、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、亜硝酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(II)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1に記載の研磨用組成物。

【請求項3】 前記(c)の酸が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リノール酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1に記載の研磨用組成物、

【請求項4】 下記の(a)～(d)の各成分を含む研

應用組成物を用いてメモリーハードディスクを研磨する  
研磨方法。

(a) 水。

(b) ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルおよびポリオキシエチレンポリオキシプロピレンコポリマーから選択される少なくとも1種類の化合物群から選択される少なくとも1種類の化合物。

(c) 硫酸、亜硫酸、硫酸、塩酸、モリブデン酸、スルファミン酸、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸、ならびにそれらの塩からなる群から選択される少なくとも1種の化合物、および

(d) 酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化ケイ素、および炭化ケイ素からなる群より選ばれる少なくとも1種の研磨材。

【請求項5】 前記(c)の酸が、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、重硝酸ナトリウム、重硫酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(III)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする研磨組成物を用いた研磨方法により、また、前記(c)の酸が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項4に記載のメモリーハードディスクを研磨する研磨方法。

【請求項6】 前記(c)の酸が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする、請求項4に記載のメモリーハードディスクを研磨する研磨方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】また、前記(c)の酸が、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする研磨用組成物により解決する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正内容】

【0021】更にまた、前記(c)の酸が、硝酸アルミニウム、硝酸ニッケル、硝酸リチウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸鉄(III)、重硝酸ナトリウム、重硫酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、硫酸リチウム、硫酸ナトリウム、硫酸鉄(III)、硫酸アンモニウム、塩化アルミニウム、塩化鉄(III)、塩化アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸アンモニウム、スルファミン酸ニッケルおよびスルファミン酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも1種であることを特徴とする研磨組成物を用いた研磨方法により、誤経を解決する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0067

【補正方法】変更

【補正内容】

【0067】3) 前記(c)の酸を、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種とすることにより、取り扱いがより容易で、かつ繊維ダメージを極めて少ないサブストレートの研磨が可能となつた。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0070

【補正方法】変更

【補正内容】

【0070】6) 前記(c)の酸を、グリシン、グリセリン酸、マンデル酸、マロン酸、アスコルビン酸、グルタミン酸、グリオキシル酸、リンゴ酸、グリコール酸、乳酸、グルコン酸、コハク酸、酒石酸、マレイン酸およびクエン酸からなる群から選択される少なくとも1種とした研磨方法により、サブストレートの研磨時におけるバッドの詰詰まりを防止し、取り扱いを容易とし、メモリーハードディスクのR.e 1.1~0.9、Dw 0.9~0.7の性能を極めて改善することができる。